

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026—038

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	天风证券：鲍荣富 北京睿石泓远：葛威乐
时间	2026 年 9 月 24 日
地点	国机精工会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：赵祥功 投资者关系助理：汪智婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	1. 问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？ 答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。 在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。 2. 问：公司在金刚石功能化应用业务上有何优势？ 答：金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布局，整体处于行业先进水平。 装备端自主可控，公司 MPCVD 设备全部自研自制，拥有新型高功率 MPCVD 法大尺寸金刚石生产线。标准端引领行业，牵头编制国内首个《热沉用金刚石片》团体标准，填补行业技术规范空白。应用端持续突破，散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程；民用领域覆盖高功率芯片、IGBT（晶体管）、消费电子等应用场景，相关产品正与下游头部客户开展合作验证。产业化支撑同步夯实，稳步推

进产业园建设。

3. 问：公司是否有金刚石钻针产品？

答：公司拥有金刚石微钻产品，当前仅在航空碳纤维打孔领域实现应用，暂未布局半导体领域。

4. 问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？

答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%。公司已形成“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户覆盖国内主流晶圆厂、封测厂与设备厂商。依托技术积淀与本土化服务优势，公司高端产品持续突破，国产替代进程不断加快。

5. 问：公司精密陶瓷制品业务的情况？

答：公司在半导体领域精密陶瓷产品上处于行业领先地位，该类产品包括陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等。应用在半导体领域的精密陶瓷制品，技术开发难度大，产品技术壁垒较高，市场前景好，是公司未来几年重点推广的产品，公司将加快其市场导入，持续提升市场占有率。

6. 问：公司半导体耗材的客户结构如何？

答：公司半导体客户按产品类型分布较清晰。金刚石工具对应的客户集中于封装领域，精密陶瓷制品客户以半导体设备厂为主。

7. 问：怎么看待公司轴承业务未来发展情况？

答：上半年轴承业务实现营业收入 8.15 亿元，同比下降 17.63%，主要受风电行业周期性变化影响。从趋势看，二季度以来收入降幅持续收窄，经营形势逐季好转。

航天特种轴承作为公司盈利的“压舱石”，传统优势地位持续稳固。产品全面覆盖卫星、运载火箭全系统关键部位，国内主流航天企业均为公司客户。可重复使用运载火箭方面，有力保障长征十号乙等国家重大航天工程任务顺利实施，配套朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成发射与回收任务验证。随着商业航天进入常态化高频发射阶段，相关业务正逐步为公司带来新的增量。

8. 问：公司在商业航天轴承的业务优势如何？

答：公司在航天领域具有很强的竞争力，且因航天轴承应用工况特殊、技术壁垒和市场门槛高，对可靠性要求高，短期内竞争相对有

	序，但长期来看不排除竞争加剧的情形。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无